

INHALT

Dezember 2018



1998

Innovative Lösungen der Elektronik eröffnen neue Möglichkeiten für Hörgeräte, Herzschrittmacher, Prothesen und medizinische Lifestyle-Produkte. Die Systeme und Komponenten für die Therapie, Diagnose und Patientenüberwachung werden immer leistungsfähiger und gleichzeitig kleiner



Für KI-to-go: Entwicklungsboard von Infineon für Edge-computing-Anwendungen



Neue Werkzeuge für PCB-Stackup-Design vom amerikanischen Hersteller Z-Zero



Dr. Hayao Nakaharas aktueller Bericht über die Leiterplattenindustrie in Südostasien

EDITORIAL

Solder Limits – ein neuer Ansatz mit vielen Fragezeichen 1889

AKTUELLES

Nachrichten/Verschiedenes 1893
 Impressionen von der Electronica 2018 1908
 Europas Waferfabs profilieren sich mit Flexibilität und Innovation 1910
 Automotive: Alles aus einer Hand 1913
 Tagungen/Fachmessen/Weiterbildung 1914
 Neue Normen 1919

BAUELEMENTE

Entwicklungs-Board für Edge-Computing-Anwendungen 1920

DESIGN

Cadence schafft Cloud-basierte Designwelt 1925

Neue Werkzeuge für PCB Stackup Design von Z-Zero 1928

LEITERPLATTENTECHNIK

Auf den Punkt gebracht (H. J. Friedrichkeit):
 Wie Automobilzulieferer den E-Bike-Markt entdecken 1941
 Teilnehmerrekord: FED traf Bedürfnisse der Branche 1949
 HDI-Technik – was berücksichtigt werden sollte 1952
 Die Leiterplattenindustrie in Südostasien 1957

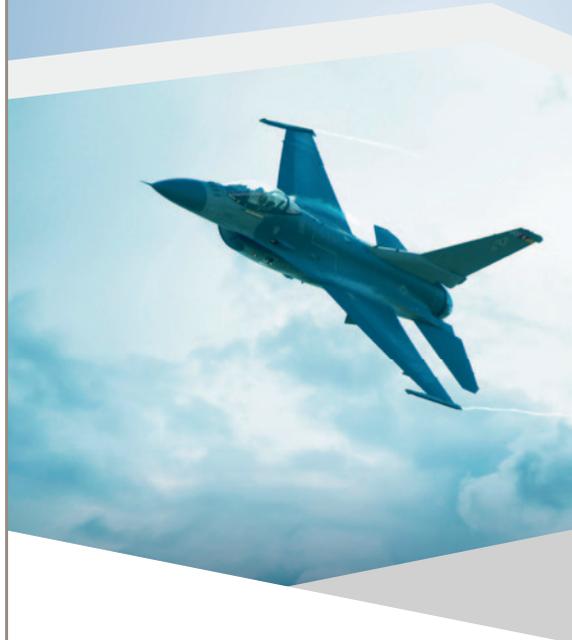
BAUGRUPPEN & SYSTEME

Hot-Spots der Elektronikfertigung – Islands of Technology 1975



ventec
INTERNATIONAL GROUP
騰輝電子

Höchste Qualitätsstandards für Aerospace & Defense durch AS9100 Rev C Zertifizierung



1975

Die Zukunft der Elektronikfertigung hatten die Referenten bei den Rehm Technology Days 2018 im Fokus



1988

„Magische Momente“ waren die Inspection Days bei Göpel in Jena unterteilt – mit Bezug auf ein neu vorgestelltes AOI-Automatisierungstool

BAUGRUPPEN & SYSTEME

EPDM entsprechend UL 94 V0 für medizinische Geräte	1981
Automotivefähige Board-Edge-Steckverbinder	1981
10-jähriges Jubiläum für Sensitive Wire Feeder	1982

ANALYTIK & TEST

Neuigkeiten und Trends im Bereich der Inspektion	1988
--	------

FORSCHUNG & TECHNOLOGIE

Neue Werkstoffe treiben die Medizinelektronik voran	1996
Miniaturisierte Leiterplatten für die Medizintechnik	1998
Patente	2000

Leiterplattenhersteller aus der Luft- & Raumfahrtindustrie und Verteidigungstechnik setzen ihr Vertrauen auf Ventec's AS9100 Rev C-akkreditierte Lieferkette für hochzuverlässige Basismaterialien und Prepregs. Von der Herstellung bis zur Lieferung ist unser gesamtes qualitativ hochwertiges Produktportfolio von Polyimiden, FR4 und unserer 'tec-speed' Serie von High-Speed/Low-Loss Materialien abgedeckt. Ventec - Ihr strategischer Partner für Ihre sicherheitskritische Lieferkette!

Ventec International Group

T: +49 (0)6352 75326-0

E: contact@ventec-europe.com

TW: Follow @VentecLaminates



Neue Standards für das Transportwesen: Das neu gegründete IPC Transportation Electronics Reliability Council will sie auf den Weg bringen

FORUM

Komponenten für Zukunftselektronik	2002
Gründung des IPC Transportation Electronics Reliability Council	2008
Kolumne: Immer mit der Ruhe und ‚ner guten Zigarre‘	2011
PLUS-Firmenverzeichnis	2015
Im Heft redaktionell erwähnte Firmen	2043
Inserentenindex	2044
Mediadaten	2045
Impressum	2047
Produkt des Monats	2048

Titelbild

BJZ ist seit Jahrzehnten ein zuverlässiger und kompetenter Partner der Elektronikindustrie. Durch langjährige Erfahrung haben wir uns als innovatives und expandierendes Unternehmen in den Bereichen des EGB-Schutzes, der Bauteilvorbereitung und der Nutzentrenntechnik eine solide Marktposition gesichert. Führende Unternehmen der Elektronikindustrie vertrauen seit Jahren auf die Fachkompetenz und Produkte der Firma BJZ.

www.bjz.de

Die Fachzeitschrift PLUS ist das Organ folgender Fachverbände:



Fachverband Bauelemente Distribution e.V.
Tel. +49 8563 9788908
a.falke@fbdi.de, www.fbdi.de

1922



Fachverband Elektronik-Design e.V.
Tel. +49 30 340 60 30 50
info@fed.de, www.fed.de

1934



EIPC – Der Europäische Elektronik-Verband
Tel. +31 46 4264258
www.eipc.org

1946



Fachverband Electronic Components and Systems
Tel. +49 69 6302-276 bzw. -251
zvei-be@zvei.org, www.zvei.org

1970



Fachverband PCB and Electronic Systems
Tel. +49 69 6302-437
PCB-ES@zvei.org, www.zvei.org



INTERNATIONAL MICROELECTRONICS AND PACKAGING SOCIETY – Deutschland e.V.
Tel. +49 3677 69-3381
martin.schneider-ramelow@imaps.de
www.imaps.de

1983



Forschungsvereinigung Räumliche Elektronische Baugruppen 3-D MID e.V.
Tel. +49 911 5302-9100
info@3dmid.de, www.3dmid.de

1991



DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V.
Tel. +49 211 1591-0
michael.weinreich@dvs-hg.de
www.dvs-ev.de

2001